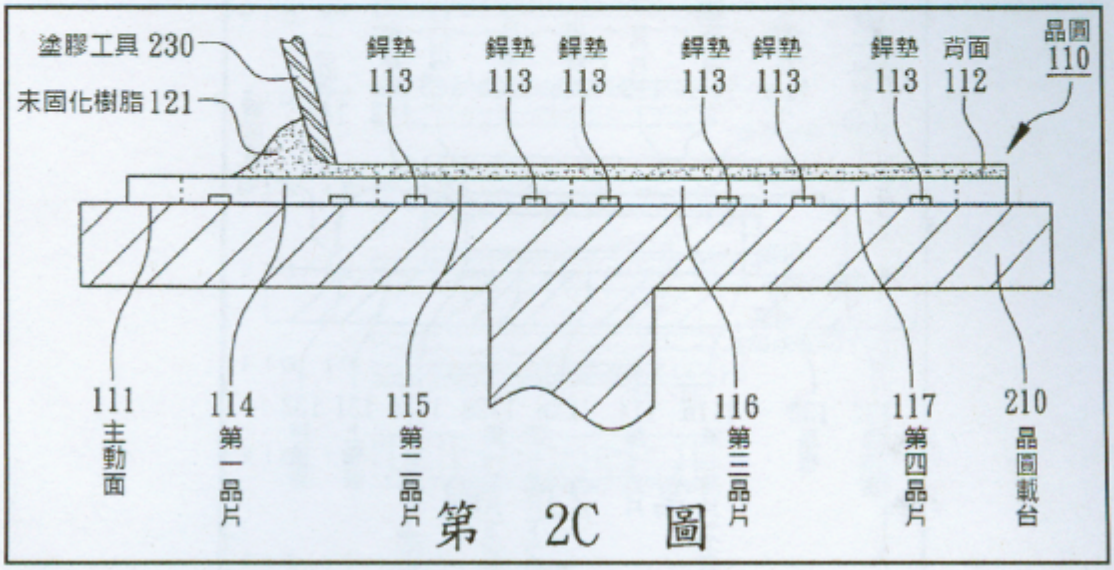
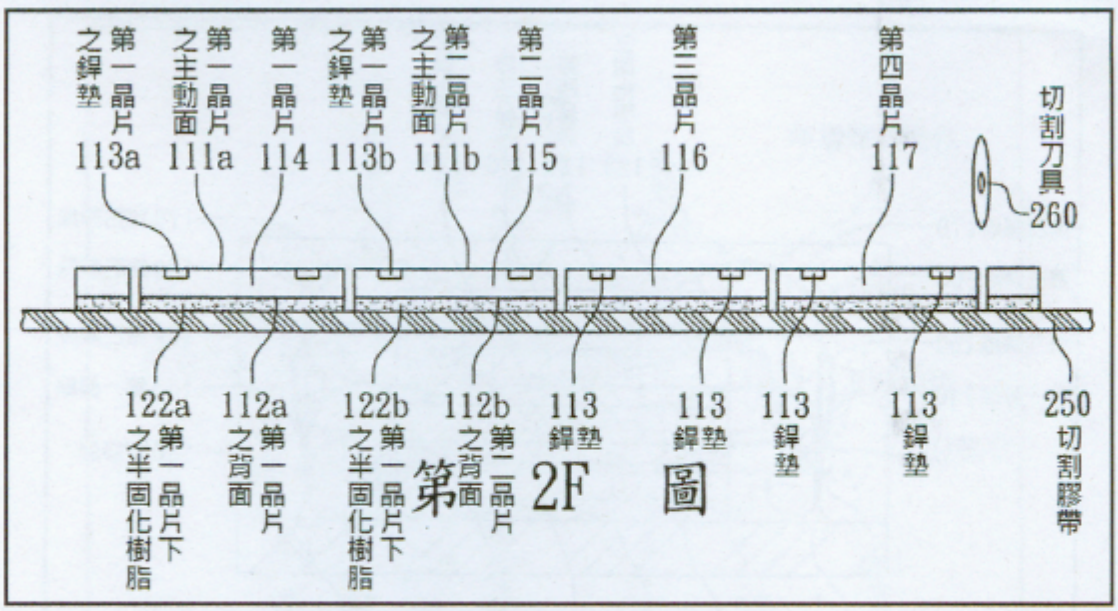
附圖一

系爭專利第 2C 圖為其製程中之截面示意圖



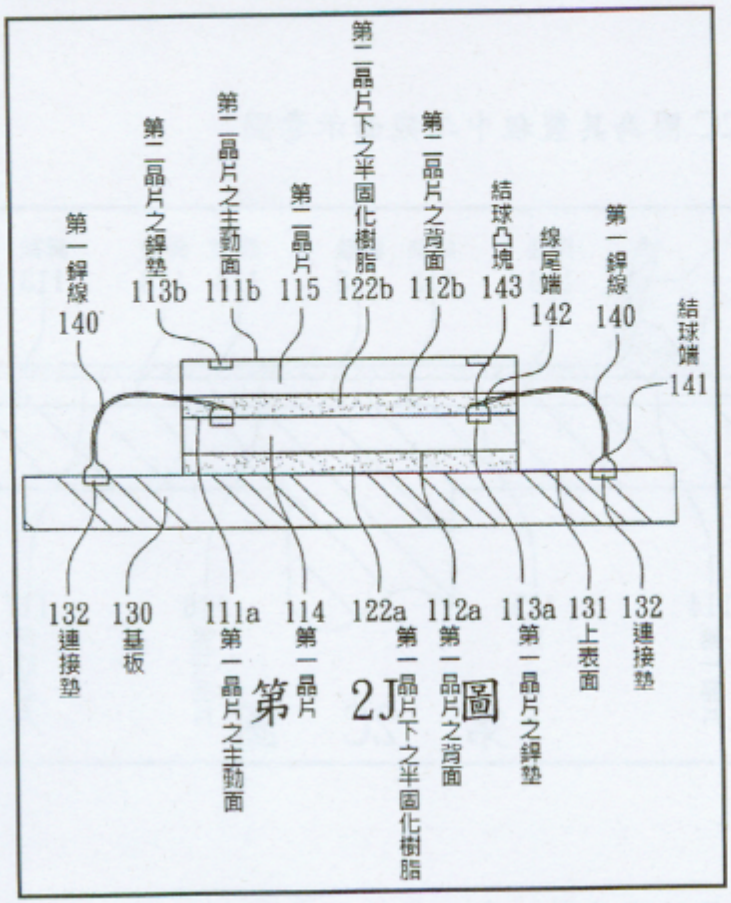

第 2C 圖

系爭專利第 2F 圖為其製程中之截面示意圖



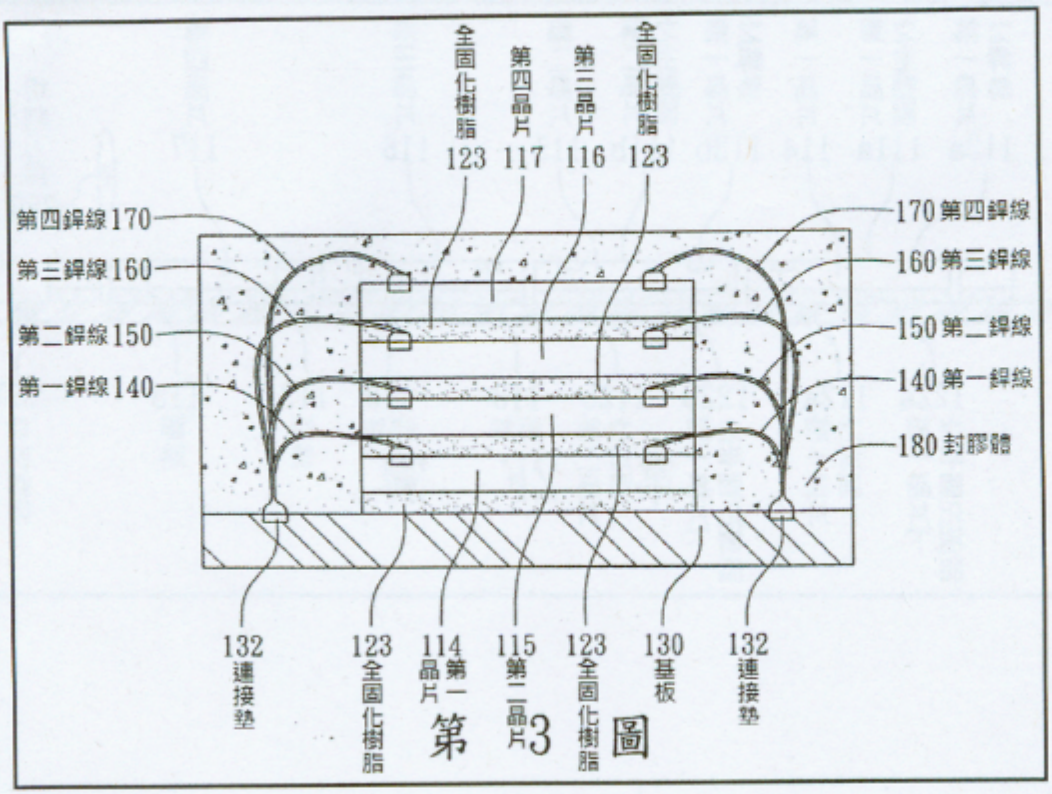

第 2F 圖

系爭專利第 2J 圖為其製程中之截面示意圖



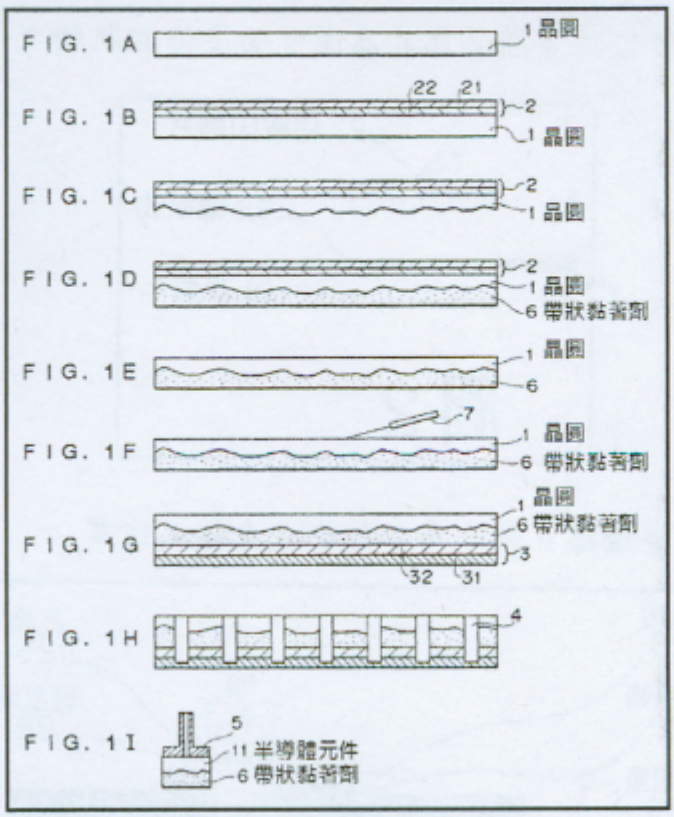

第 2J 圖

系爭專利第 3 圖為其封裝構造之截面示意圖

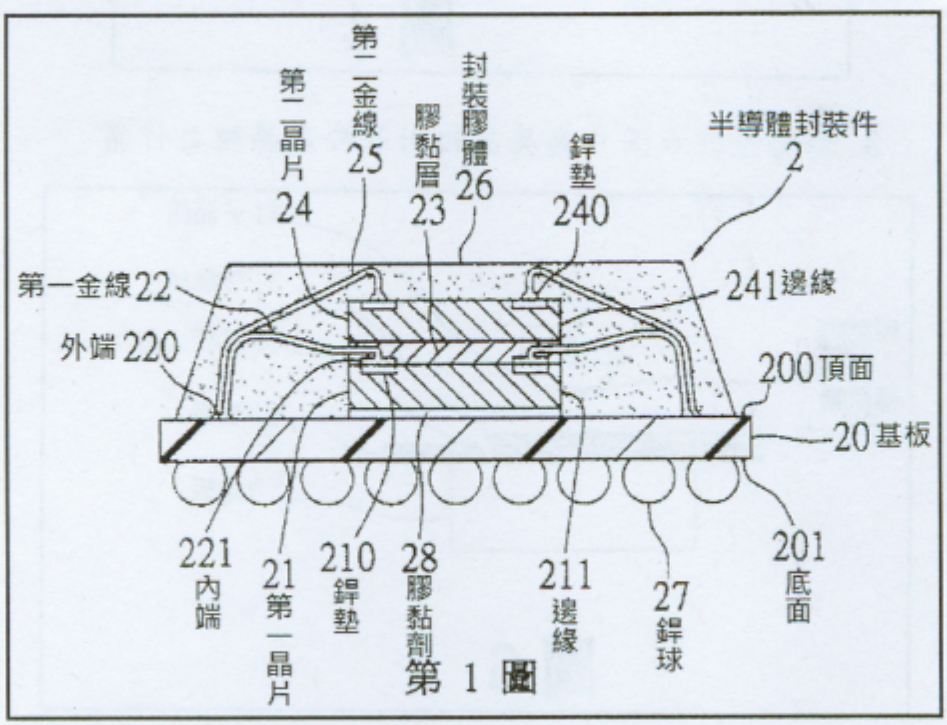



第 3 圖

附圖二：舉發證據 1 之剖視圖




附圖三：舉發證據 4 之剖視圖




第 1 圖

附圖四：舉發證據 6 之主要圖示

1. 舉發證據 6 圖 2 為其晶圓背面塗佈糊狀物之作業

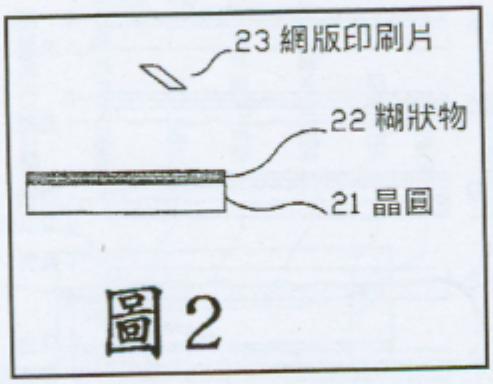


圖 2

2. 舉發證據 6 圖 4 為其晶粒被夾起之作業

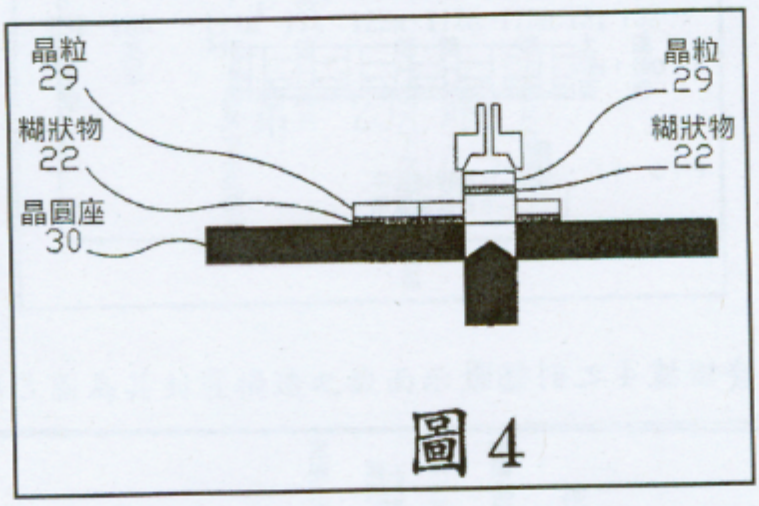


圖 4

3. 舉發證據 6 圖 6 為其晶粒附著於母晶粒之作業

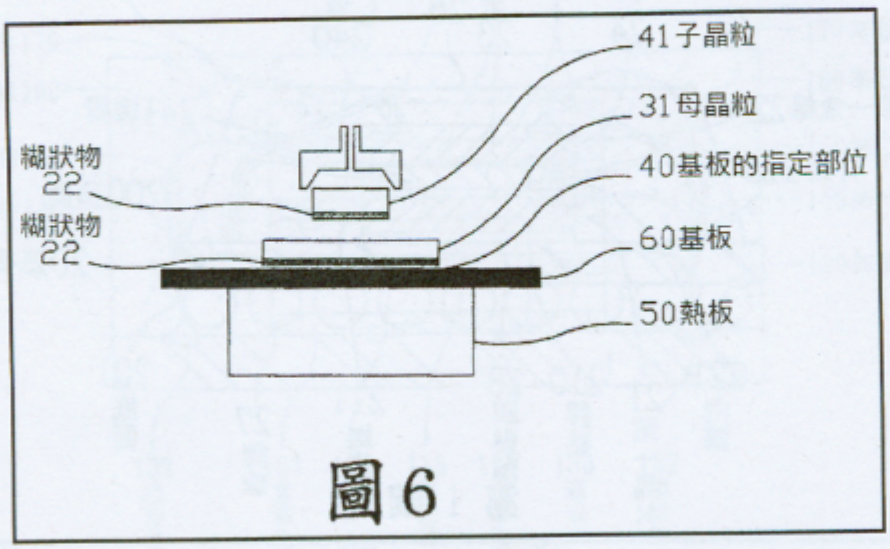


圖 6